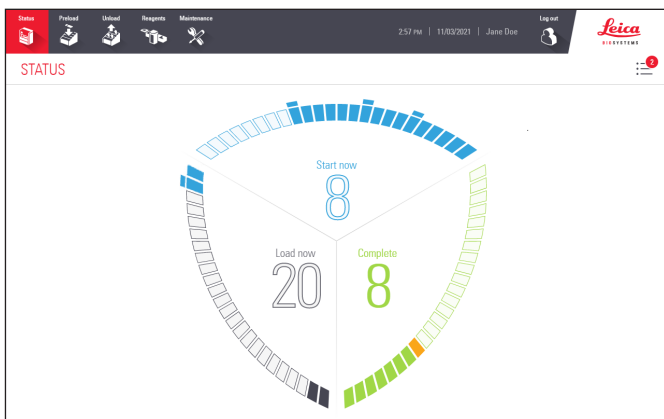


Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

BOND-PRIME- pikaohjeet



CE

Sisällysluettelo

BOND-PRIME-prosessointimoduulin käynnistys

- » Käynnistysmenettely

Kirjautuminen sisään ja ulos

- » Kirjautuminen sisään
- » Kirjautuminen ulos

Toimintojono ja varoituspalkki

- » Toimintojonon näyttäminen ja piilottaminen
- » Toimintojono kohteessa osoitetun tehtävän suorittaminen
- » Tehtävän suorittaminen varoituspalkin piilottamiseksi

Esimerkki objektilasien käsittelytapahtuman järjestyksestä *

- » Reagent Trayn (reagenssialusta) ja DS9824 Detection Systemin lataaminen
- » Objektilasien esilataaminen, käsitteleminen ja tyhjentäminen

Vaaditut puhdistustehtävät

- » Huollon käynnistäminen (kirjautuminen vaaditaan)
- » Suction Cupin (imukuppi) puhdistaminen
- » ARC Modulin (ARC-moduulit) sisäpintojen pyyhkiminen
- » BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) käyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)

Vaaditut huoltotehtävät

- » DI Water Containerin (deionisoidun veden säiliö) täyttäminen
- » Alcohol Containerin (alkoholisäiliö) täyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)
- » Lukittujen Reagent Containerien (reagenssisäiliöt) täyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)
- » Jäteastioiden tyhjentäminen
- » BOND-PRIME ARC Refresh Kitin käyttäminen
- » Huollon lopettaminen (kirjautuminen vaaditaan)

Sammutustoimenpiteet

- » Prosessointimoduulin sammuttaminen (kirjautuminen vaaditaan)
- » Prosessointimoduulin irrotus (kirjautuminen vaaditaan)

* olettaen, että seuraavat alustavat tehtävät on suoritettu:

- » Protokolla- ja reagenssitarkistukset
- » Objektilasien asettaminen (aina objektilasien merkitsemiseen asti).

Lisätietoja on BOND-järjestelmän käyttöoppaan Pikaopas-luvussa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Leica Biosystems paikalliseen edustajaan myynti-, huolto- ja tukiasioissa. Kaikkien alueiden yhteystiedot löytyvät verkkosivustoltamme:

LeicaBiosystems.com

Lisätietoja on BOND-PRIME-käyttöoppaassa.

Käyttötarkoitus

BOND-järjestelmä automatisoi kliiniset protokollat mikroskooppiobjektileihin kiinnitettyjen patologisten näytteiden immunovärykseen. Pätevä terveydenhuollon ammattilainen tulkitsee mikroskooppiobjektileit myöhemmin diagnoosin helpottamiseksi.



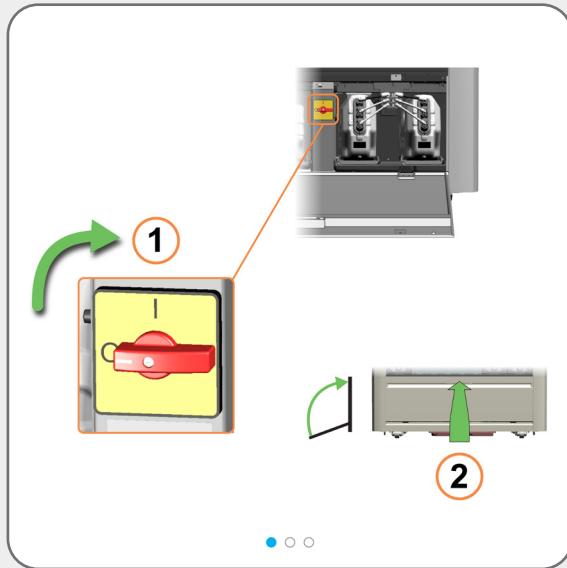
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mount Waverley VIC 3149
Australia

Muutokset			
Versio	Julkaistu	Muutetut kohdat	Tiedot
A07	Joulukuu 2023	BOND-PRIME ARC Refresh Kitin käyttäminen	Pienet korjaukset.
A06	Toukokuu 2023	Kaikki	Käännöskorjaukset
A05	Tammikuu 2023	Kaikki	Ensimmäinen julkaisu.
A01 - A04	-	-	Ei julkaistu.

Tekijänoikeus © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. LEICA ja Leica-logo ovat Leica Microsystems IR GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. BOND-PRIME on Leica Biosystems ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Muut logot, tuotenimet ja/tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

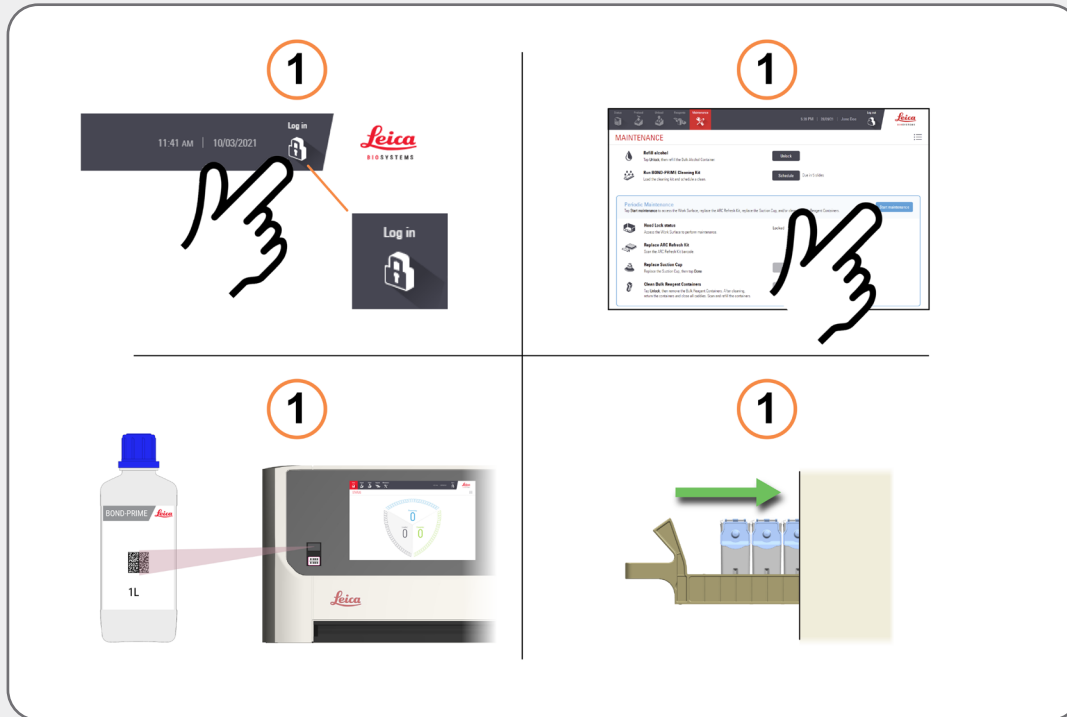
BOND-PRIME-prosessointimoduulin käynnistys

Käynnistysmenettely



Kirjautuminen sisään ja ulos

Kirjautuminen sisään

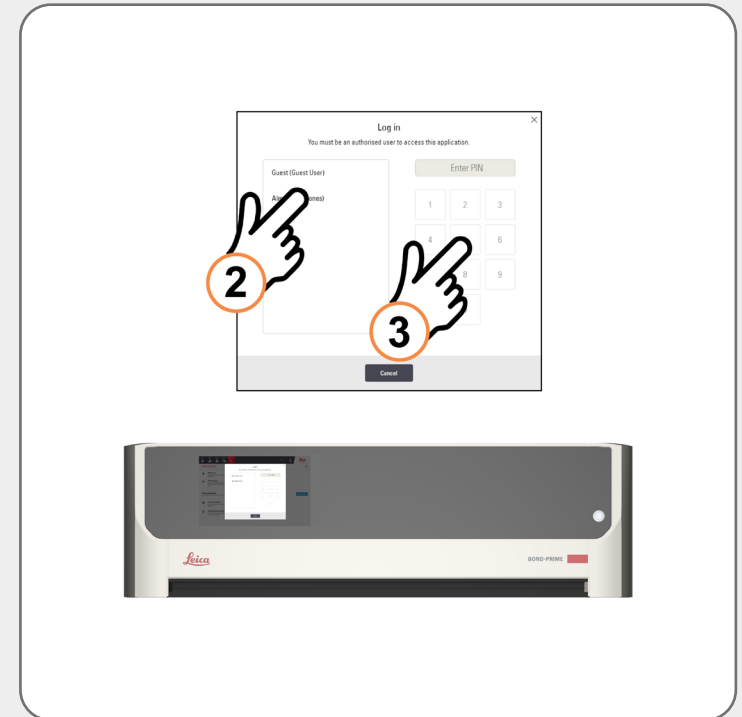


Jos kukaan ei ole kirjautuneena sisään, useat toiminnot avaavat **Log in** (kirjaudu sisään) -ikkunan, esimerkiksi:

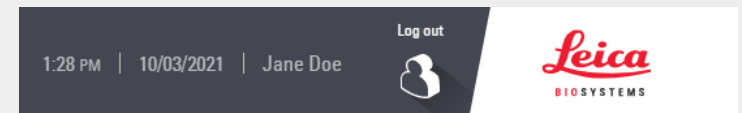
- » **Log in** (kirjaudu sisään) -painikkeen napauttaminen
- » huoltonäytön **Start maintenance** (käynnistä huolto) -painikkeen napauttaminen
- » bulkkireagenssin täyttöpullon viivakoodin skannaaminen
- » Reagent Trayn (reagenssilusta) lataaminen Reagent Platformille (reagenssilava)

Napauta seuraavaksi **Log in** (kirjaudu sisään) -ikkunassa käyttäjänimesi ja syötä sitten PIN-koodisi.

Kun olet kirjautunut sisään onnistuneesti, nimesi näkyy päivämäärän vieressä.

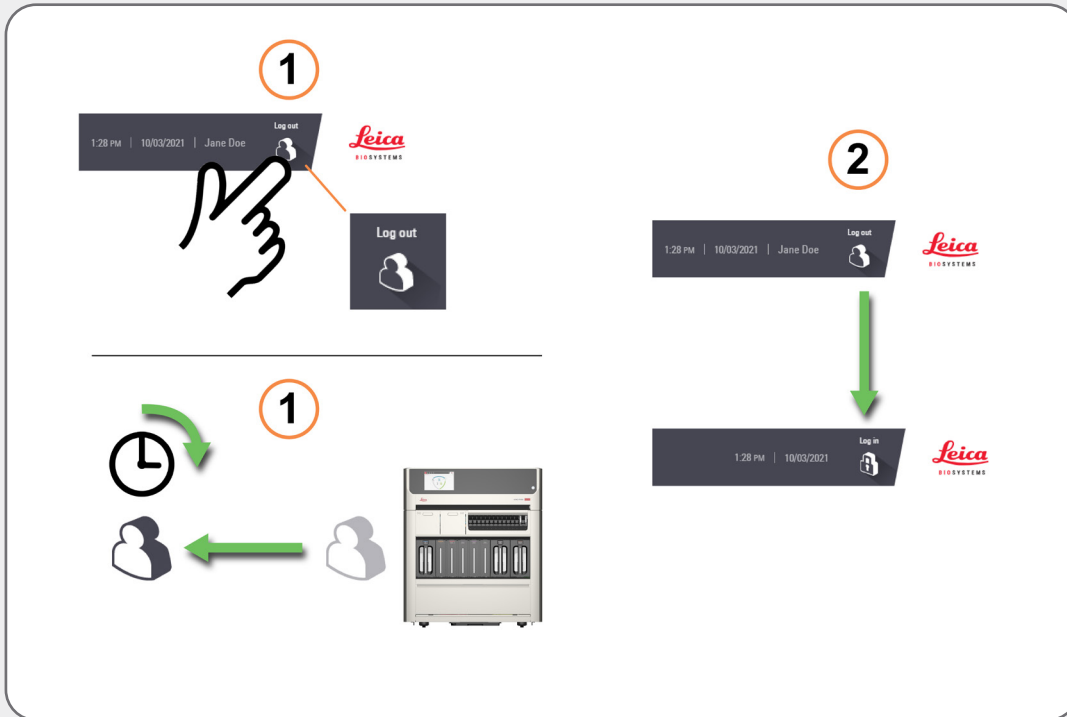


Lisätietoja PIN-koodin asettamisesta tai muuttamisesta on erillisessä BOND-järjestelmän käyttöoppaassa.



Kirjautuminen sisään ja ulos

Kirjautuminen ulos



Kirjaudu ulos napauttamalla **Log out** (kirjaudu ulos) -painiketta.

Tai jos et ole vuorovaikutuksessa prosessointimoduulin kanssa ennalta määrätyn ajanjakson kuluessa, sinut kirjataan ulos automaattisesti.



Voit muuttaa tätä ajanjaksoa BOND-ohjaimen Administration Clientissa. Katso lisätietoja erillisestä BOND-järjestelmän käyttöoppaasta.

Toimintojono ja varoituspalkki

Toimintojonon näyttäminen ja piilottaminen



Näytä ja piilota toimintojono napauttamalla painiketta.

Voit näyttää enemmän tai vähemmän tietoja kustakin toimintojonon kohteesta napauttamalla kohteen oikealla puolella olevaa nuolta.

Kuvake osoittaa kunkin toimintojonon tärkeystasoa:



Varoitus: Toimi välittömästi.



Huomio: Toimi heti, kun mahdollista.



Tietoa: Tiedoksi.

Toimintojono-painikkeen numero ilmaisee ainoastaan varoitusten ja huomautusten määrän.

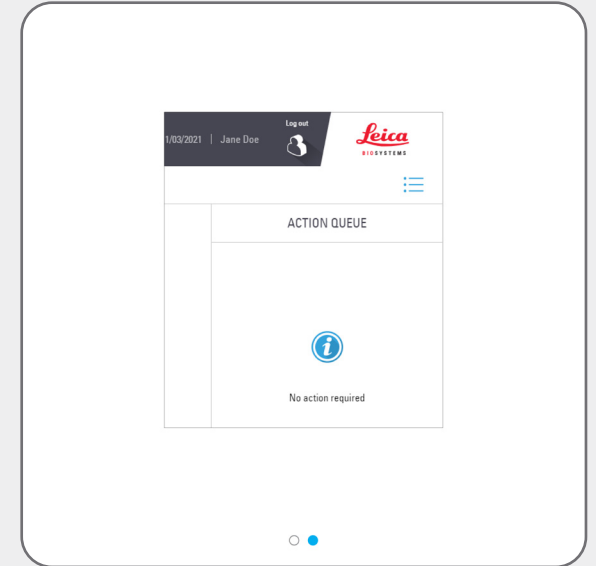
Toimintojono ja varoituspalkki

Toimintojono kohteessa osoitetun tehtävän suorittaminen



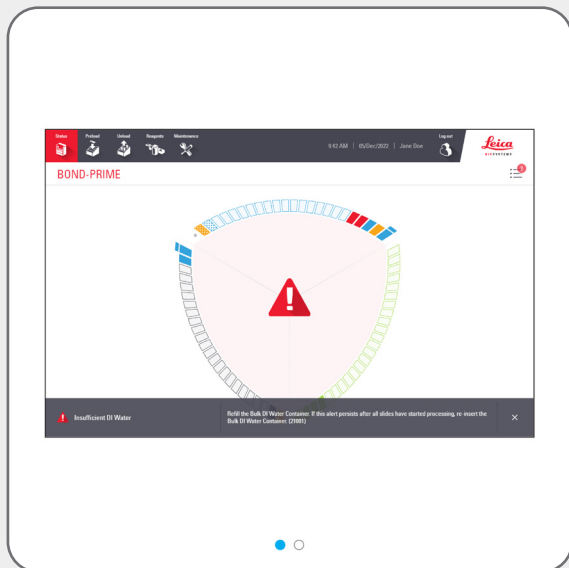
Tehtävä voi liittyä huoltoon.

Tutustu tässä tapauksessa
BOND-PRIME-käyttöoppaan
Huoltotehtävät-kohtaan.



Toimintojono ja varoituspalkki

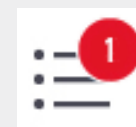
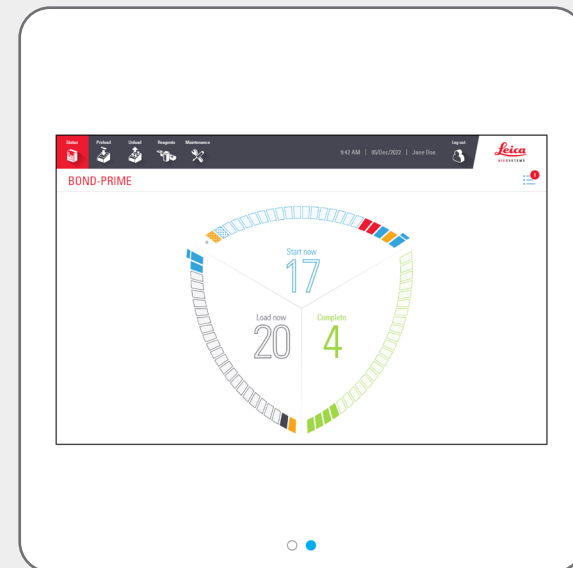
Tehtävän suorittaminen varoituspalkin piilottamiseksi



Vaikka voitkin piilottaa BOND-PRIME-ohjelmistossa varoituspalkin manuaalisesti, on mainittu tehtävä suoritettava mahdollisuuksien mukaisesti.

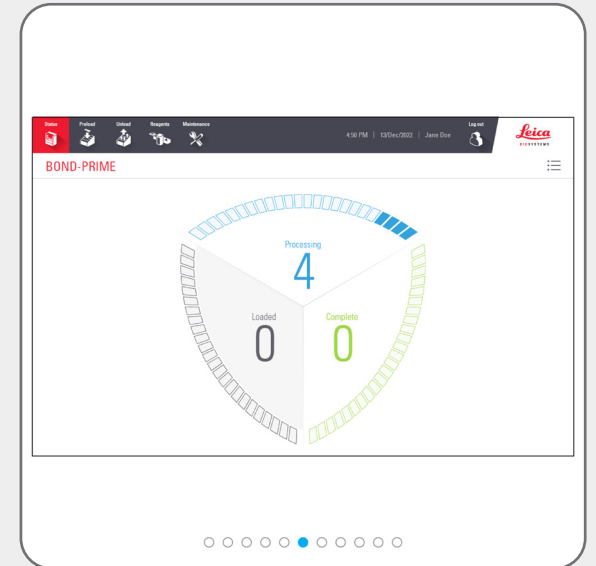
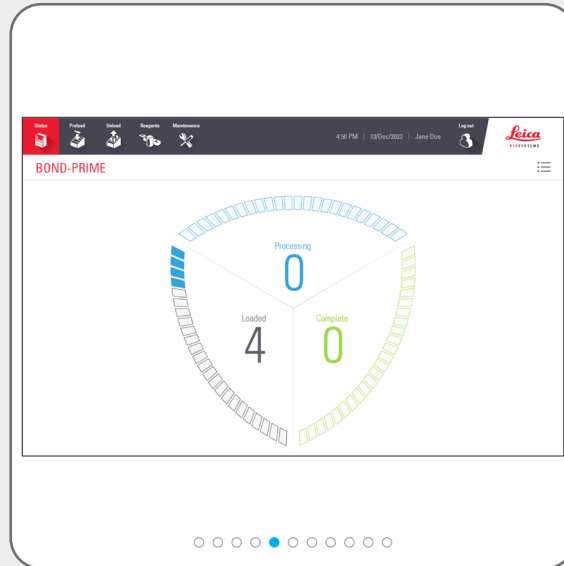
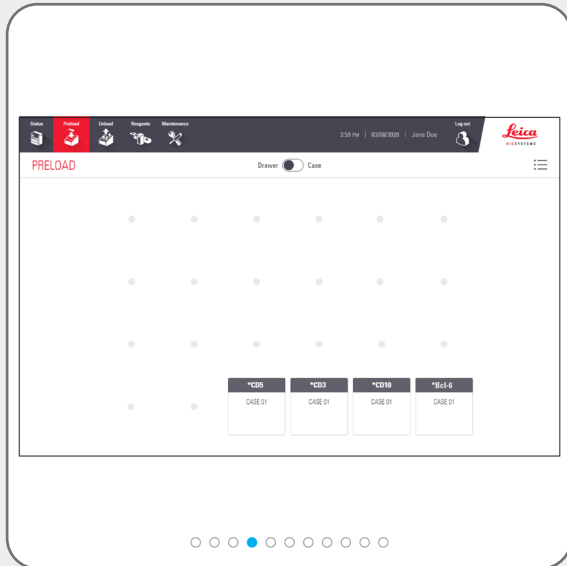
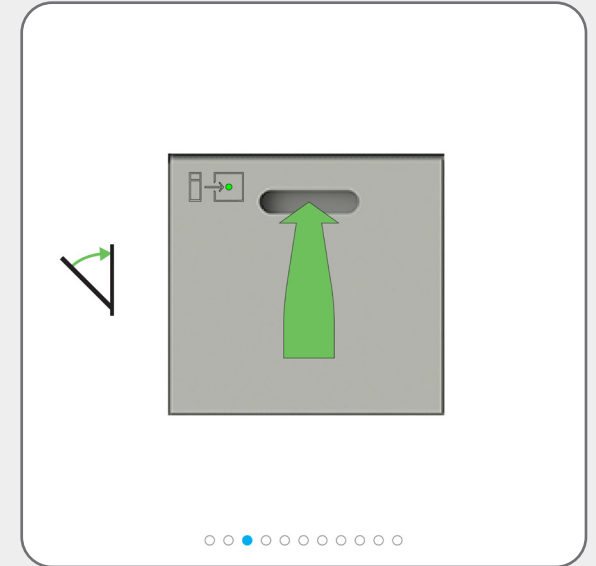
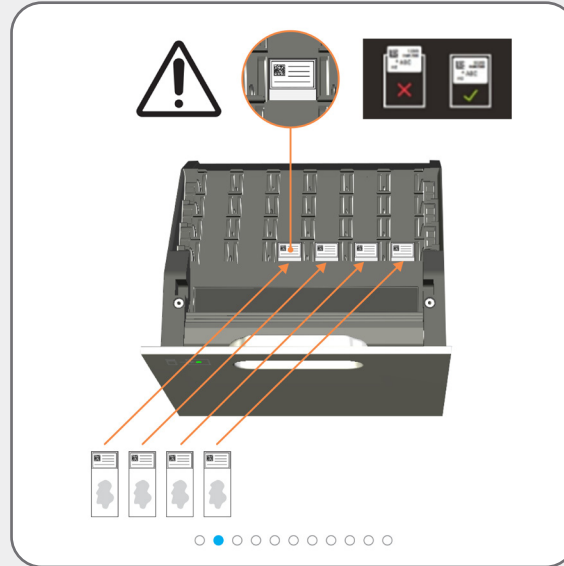
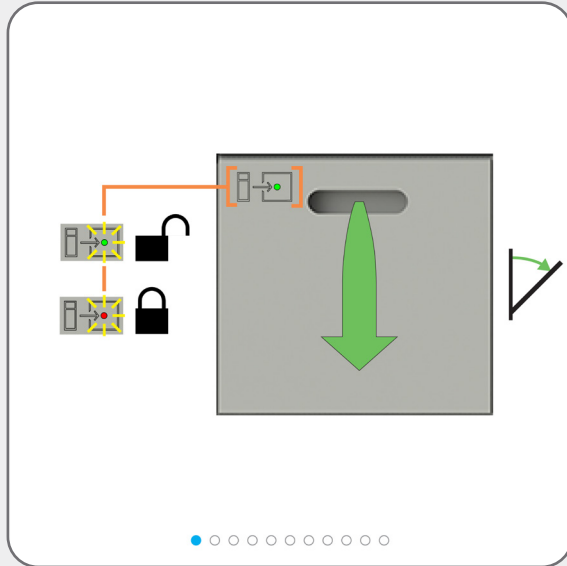
Ehdotettu tehtävä voi liittyä huoltoon.

Tutustu tässä tapauksessa BOND-PRIME-käyttöoppaan **Huoltotehtävät**-kohtaan.



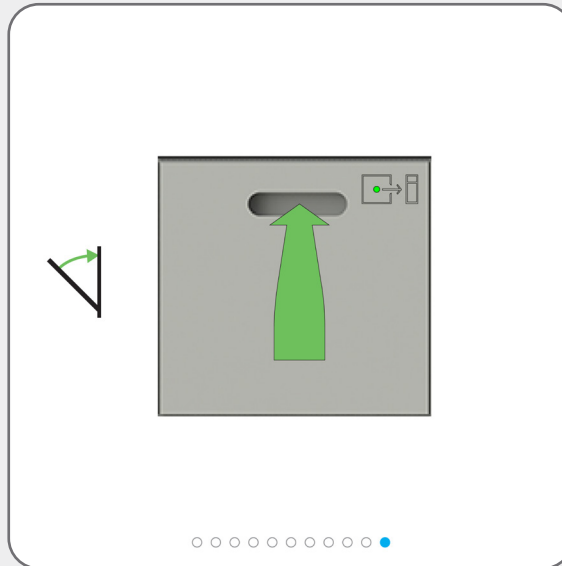
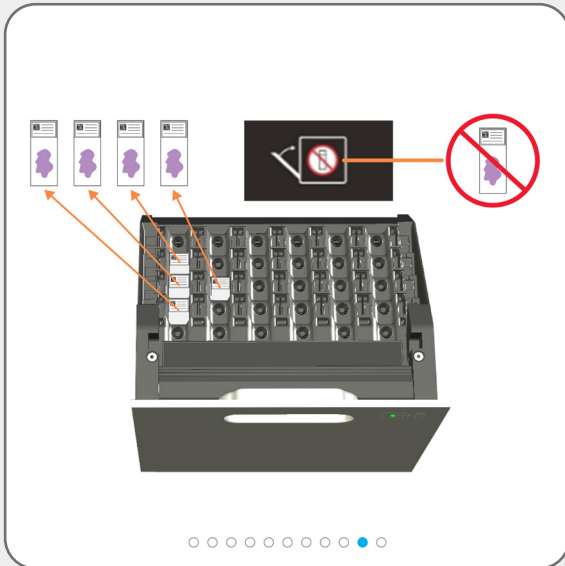
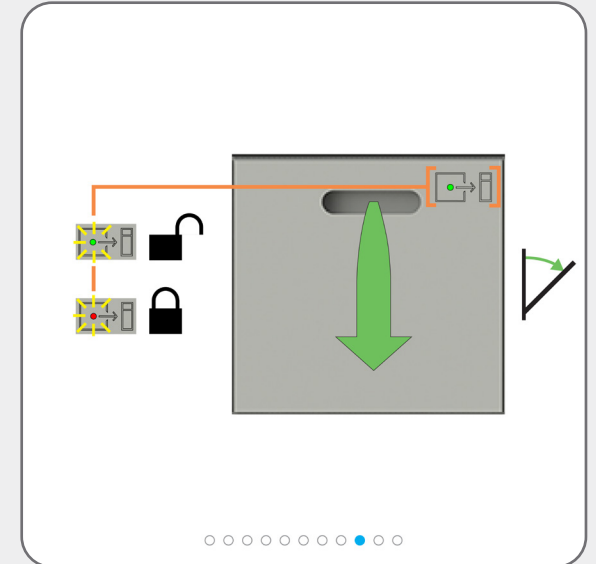
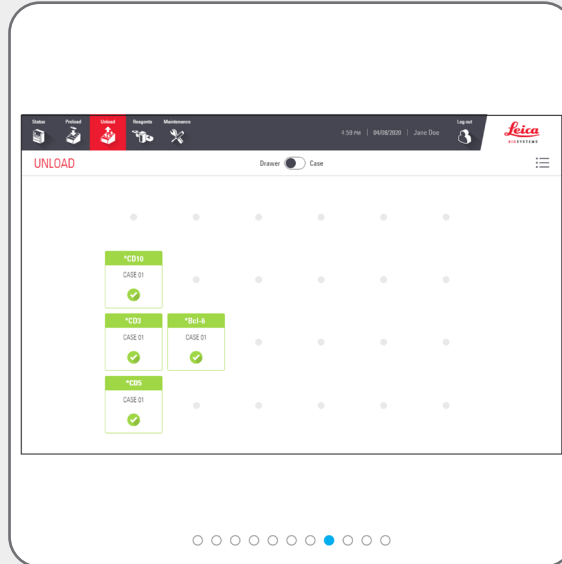
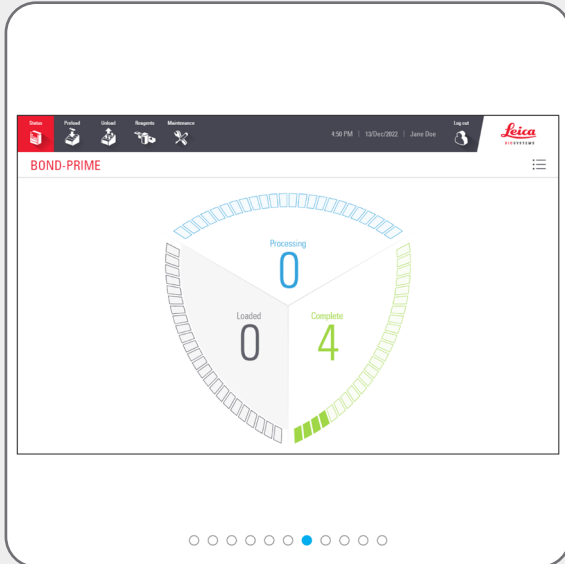
Esimerkki objektilasien käsittelytapauksen järjestyksestä

Objektilasien esilataaminen, käsitteleminen ja tyhjentäminen



Esimerkki objektilasien käsittelytapauksen järjestyksestä

Objektilasien esilataaminen, käsitteleminen ja tyhjentäminen



Pura **kaikki** valmiit objektilasit usein. Jos Unload Drawer (purkulaatikko) täyttyy, se voi estää käsittelyn ja pidentää arvioitua valmistumisaikaa. Unload Drawerissa (purkulaatikko) **ei saa** olla objektilaseja, kun se suljetaan.



Pura reagenssit, joita ei enää tarvita. Sulje Reagent Containerien (reagenssisäiliöt) kannet tiiviisti estääksesi reagenssin haihtumisen ja varastoi reagenssit välittömästi etiketissä tai reagenssin tietolomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vaaditut puhdistustehtävät

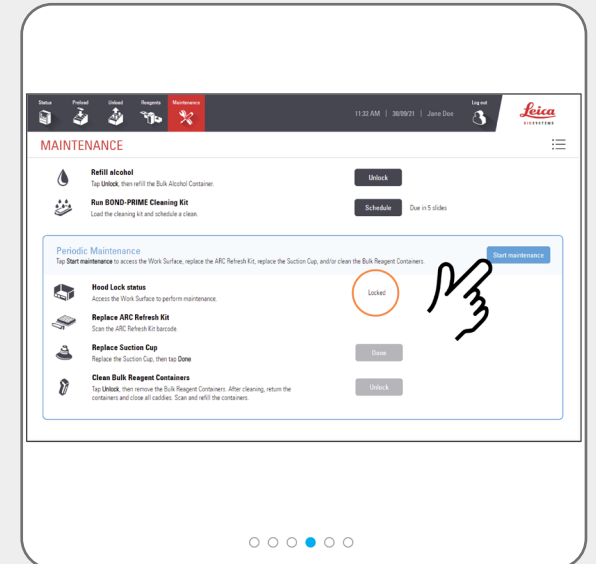
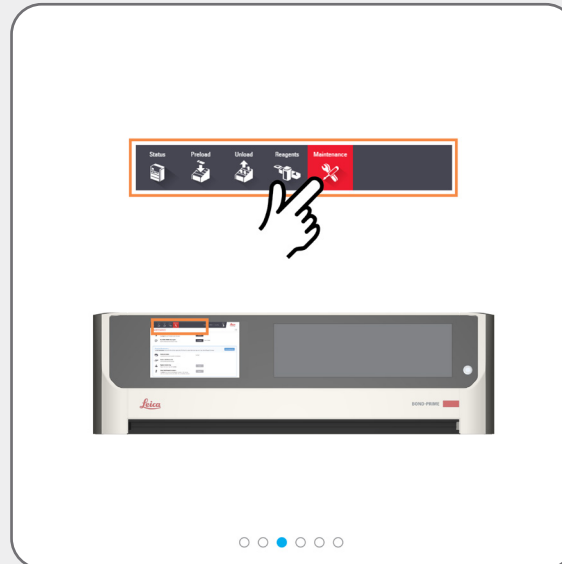
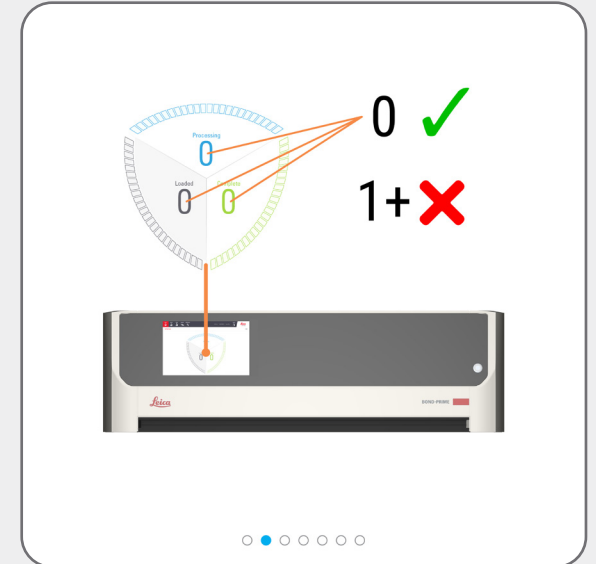
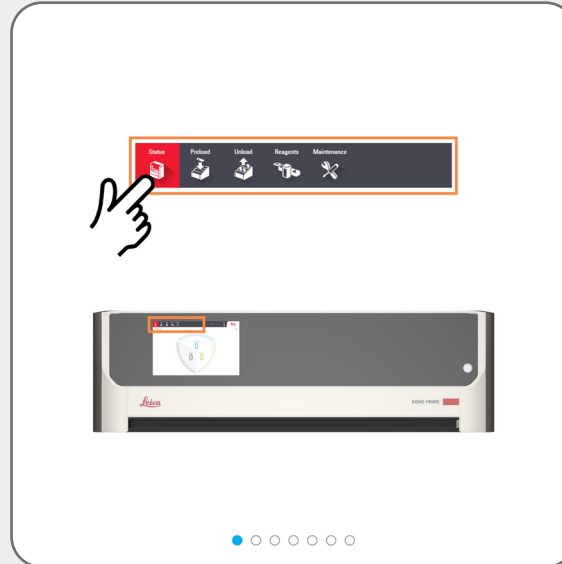
Huollon käynnistäminen (kirjautuminen vaaditaan)



Käytä Start Maintenance (käynnistä huolto) -toimenpidettä avatessasi Work Surfacen (työskentelytaso), puhdistaessasi bulkkireagenssisäiliöitä, vaihtaessasi Suction Cupin (imukuppi) tai suorittaessasi toimenpiteen [BOND-PRIME ARC Refresh Kitin käyttäminen](#).

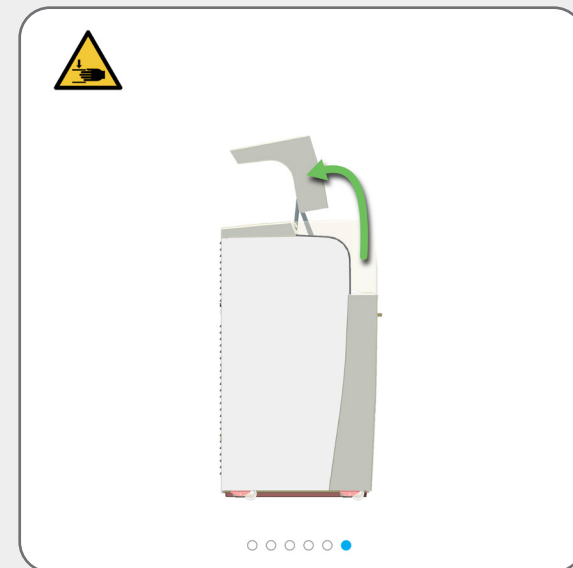
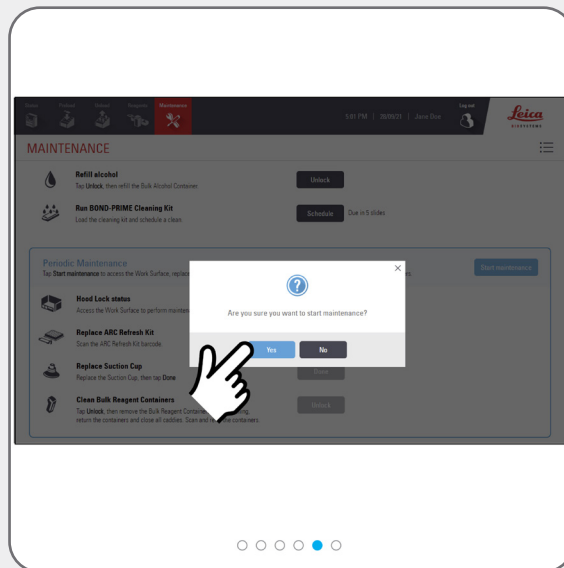
Katso tilanäyttöä ennen huoltotehtävän aloittamista.

Varmista, että objektilaseja ei juuri nyt käsitellä eikä Preload and Unload Drawereissa (esilatauslaatikot ja purkulaatikko) ole objektilaseja.



Vaaditut puhdistustehtävät

Huollon käynnistäminen (kirjautuminen vaaditaan)



Vaaditut puhdistustehtävät

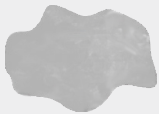
Suction Cupin (imukuppi) puhdistaminen



[Valitse Huollon käynnistäminen \(kirjautuminen vaaditaan\)](#) päästäksesi Work Surfaceen (työskentelytaso) ja avataksesi ARC Moduulet (ARC-moduulit).



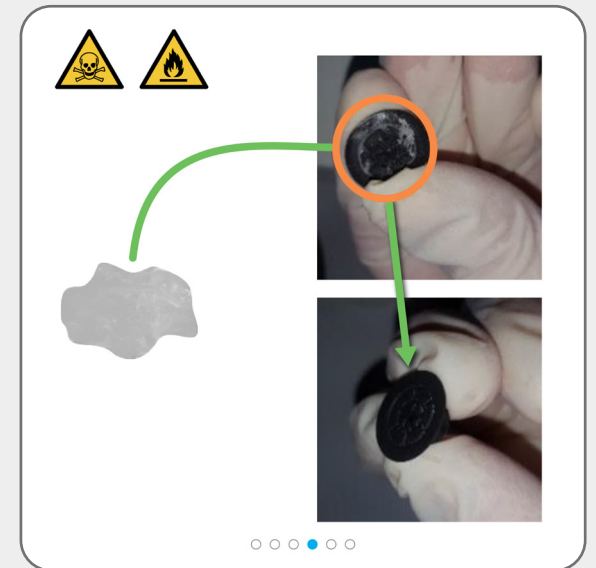
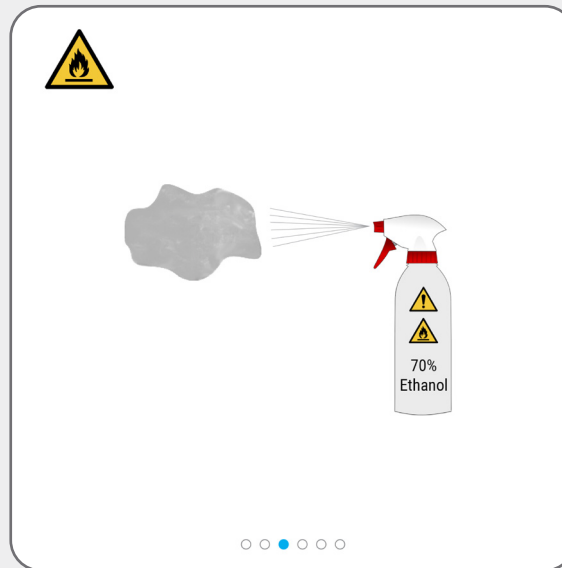
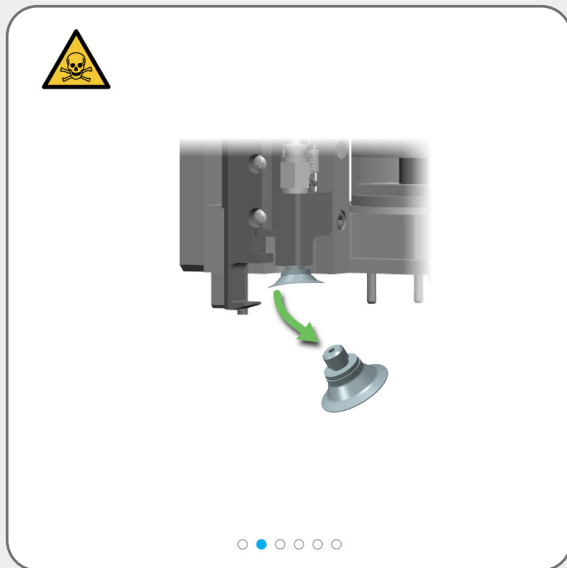
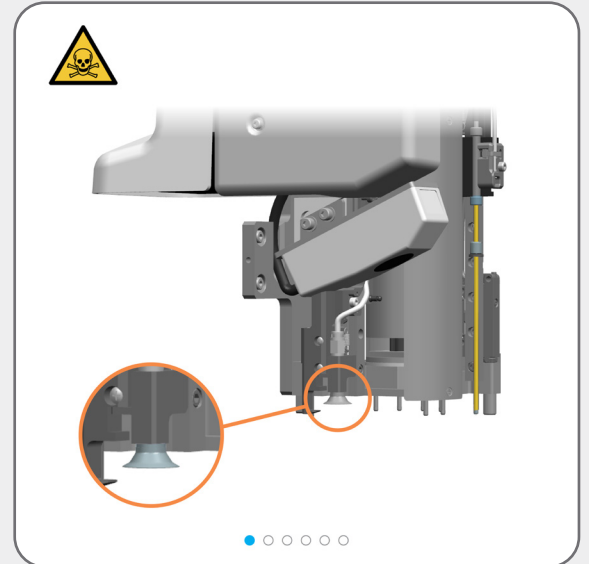
VAROITUS: Sinun on käytettävä vaadittuja henkilösuojaimia ennen prosessointimoduulin puhdistamista.



Käytä puhdasta nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu 70 % etanoliliuoksella.

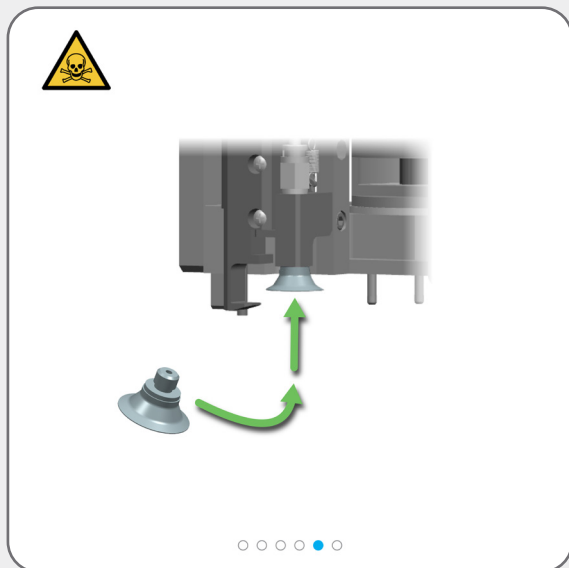


Välttääksesi Suction Cupin (imukuppi) putoamisen prosessointimoduulin, siirrä High-Speed Robot (pikarobotti) varovasti Reagent Platformin (reagenssilava) päälle.

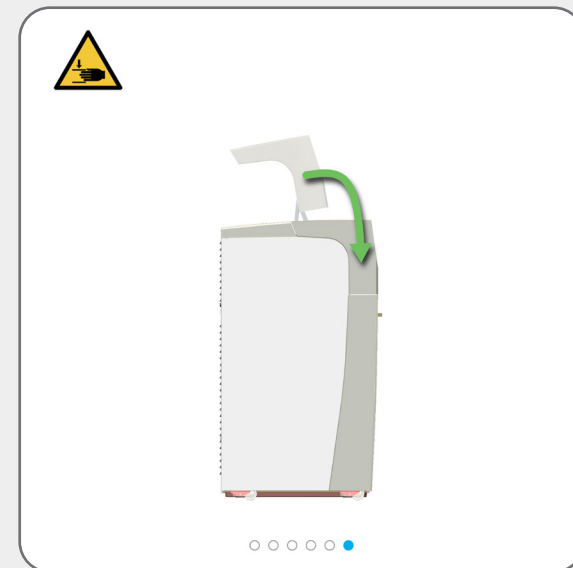


Vaaditut puhdistustehtävät

Suction Cupin (imukuppi) puhdistaminen



Jos et enää tarvitse pääsyä Work Surfaceen (työskentelytaso), sulje kansi ja valitse [Huollon lopettaminen](#) (kirjautuminen vaaditaan).



Vaaditut puhdistustehtävät

ARC Modulien (ARC-moduulit) sisäpintojen pyyhkiminen



[Valitse Huollon käynnistäminen \(kirjautuminen vaaditaan\)](#) päästäksesi Work Surfaceen (työskentelytaso) ja avataksesi ARC Moduulet (ARC-moduulit).



VAROITUS: Sinun on käytettävä vaadittuja henkilösuojaimia ennen prosessointimoduulin puhdistamista.



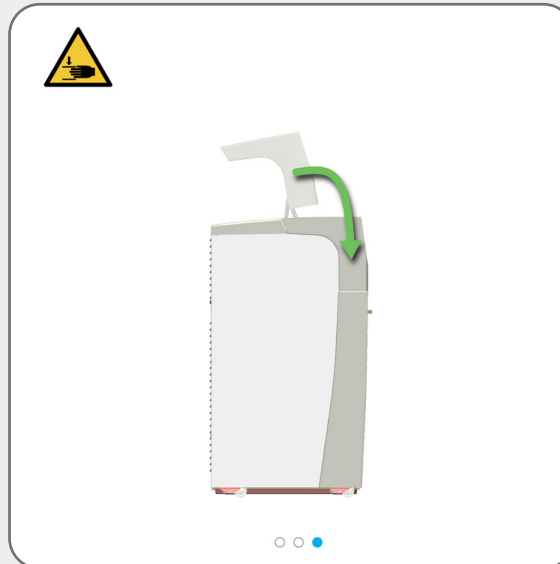
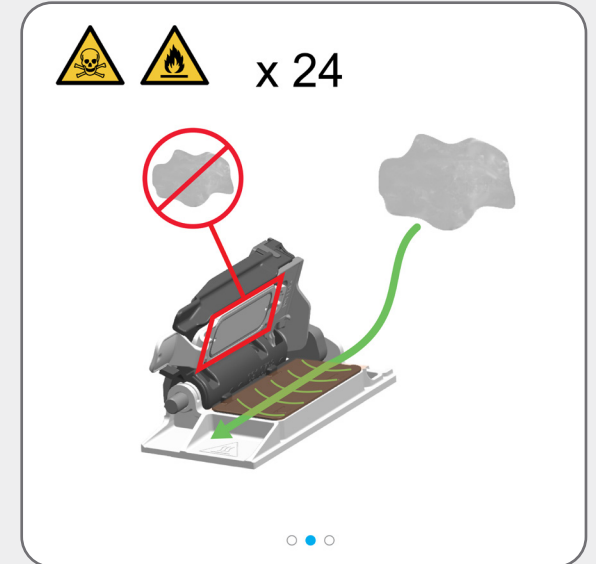
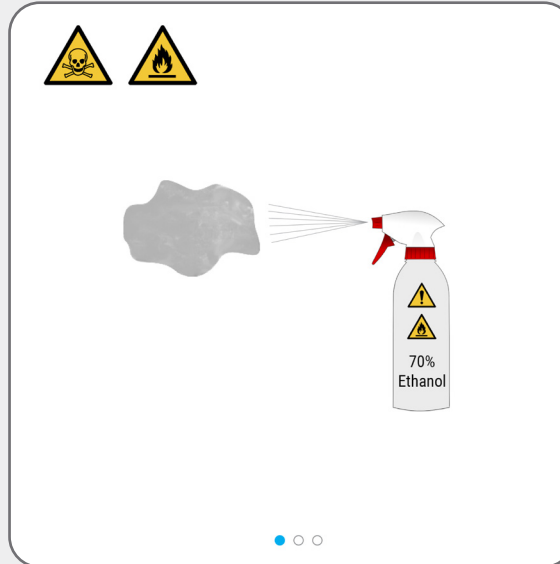
Käytä puhdasta nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu 70 % etanoliliuoksella.



Prosessointimoduuli sulkee ARC Moduulet (ARC-moduulit) automaattisesti, kun lopetat huollon.

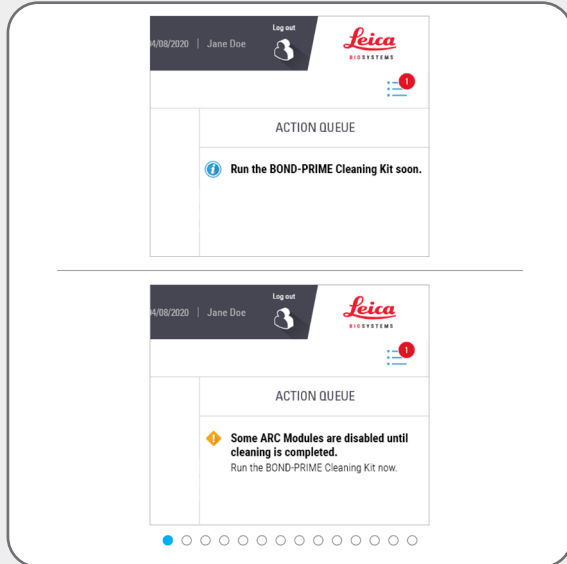


Jos et enää tarvitse pääsyä Work Surfaceen (työskentelytaso), sulje kansi ja valitse [Huollon lopettaminen \(kirjautuminen vaaditaan\)](#).



Vaaditut puhdistustehtävät

BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) käyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)



Käytä BOND-PRIME Cleaning Kitä (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) pian



Jotkin ARC Moduulet (ARC-moduulit) ovat pois käytöstä, kunnes puhdistus on suoritettu.



Käytä BOND-PRIME Cleaning Kitä (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) nyt.



ARC Moduulet (ARC-moduulit) on puhdistettava, kun käyttömäärä on välillä 17–23.

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) on rekisteröitävä BOND-ohjaimen (katso lisätietoja BOND-järjestelmän käyttöoppaasta).



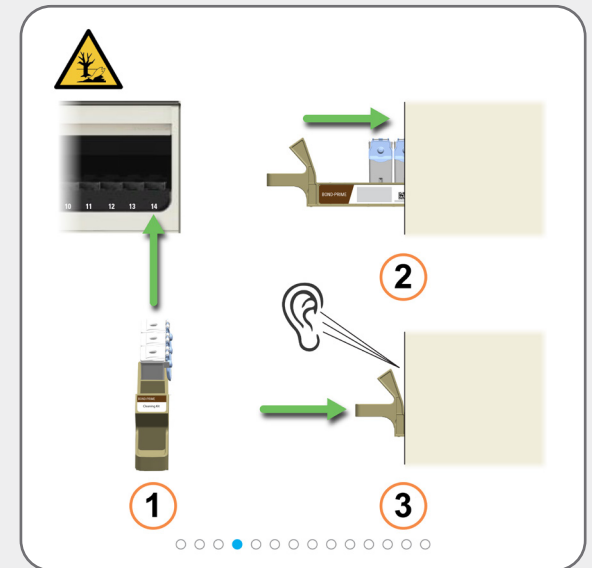
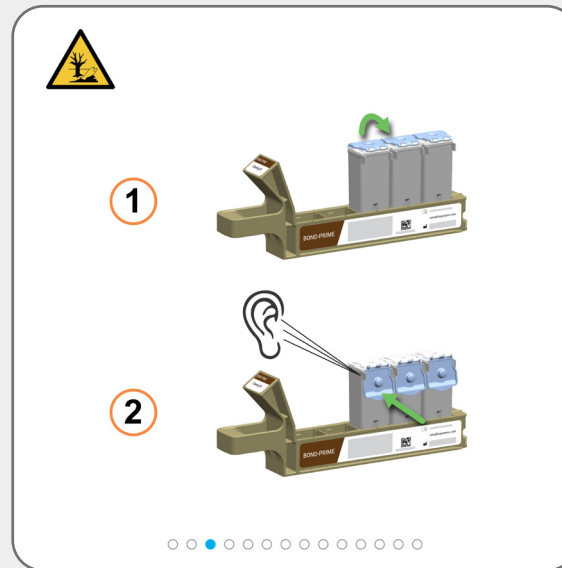
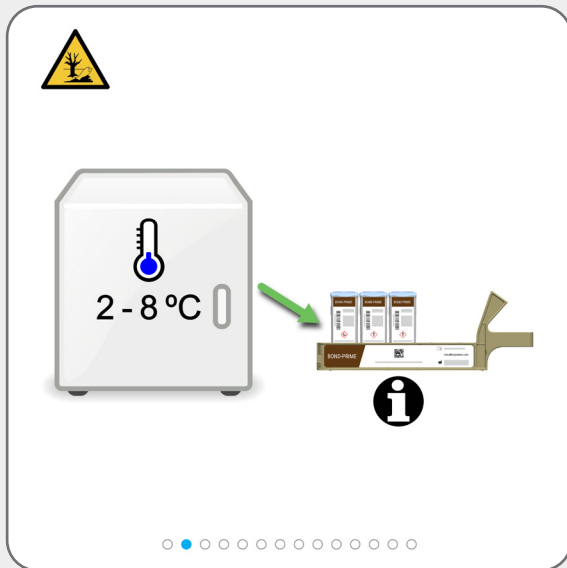
Tarvittaessa:

[DI Water Containerin \(deionisoidun veden säiliö\) täyttäminen](#)

[Alcohol Containerin \(alkoholisäiliö\) täyttäminen \(kirjautuminen vaaditaan\)](#)

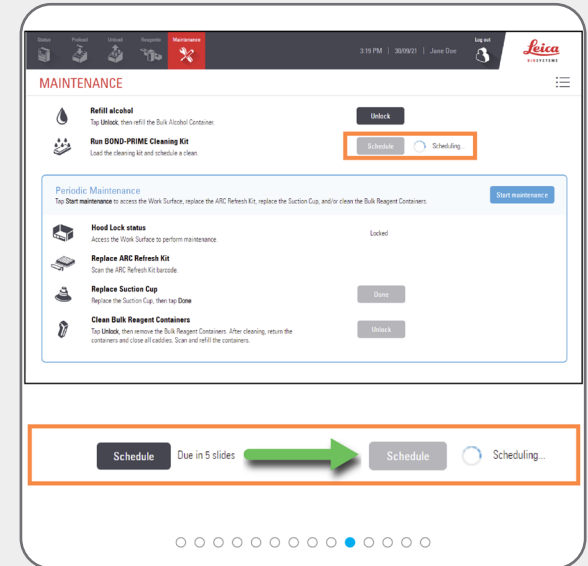
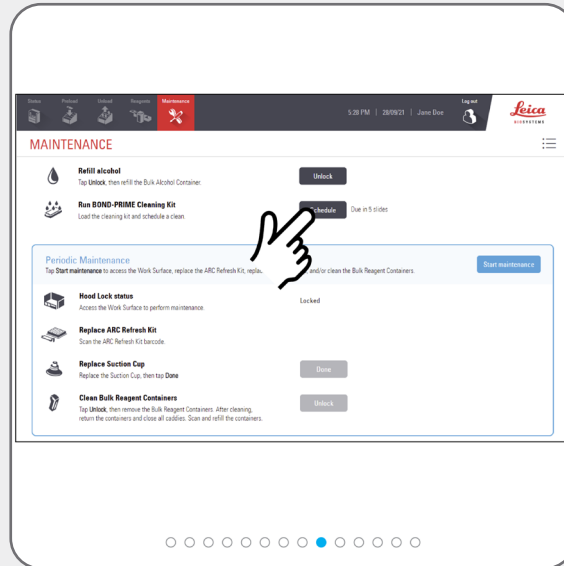
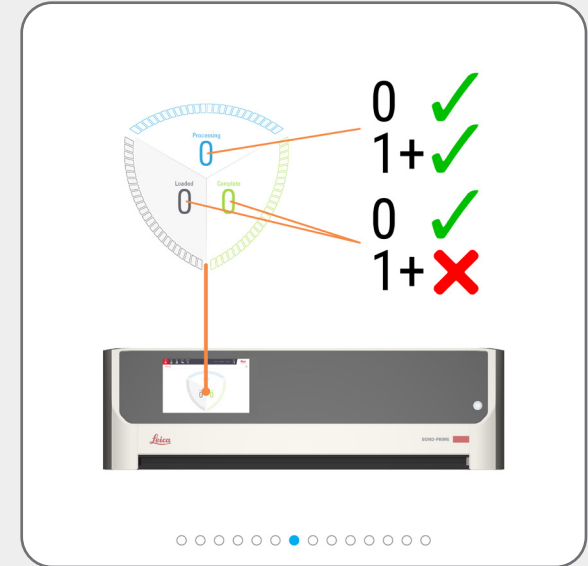
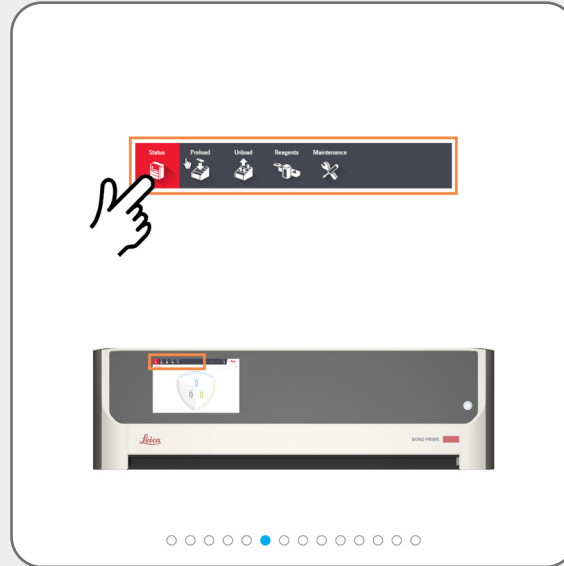
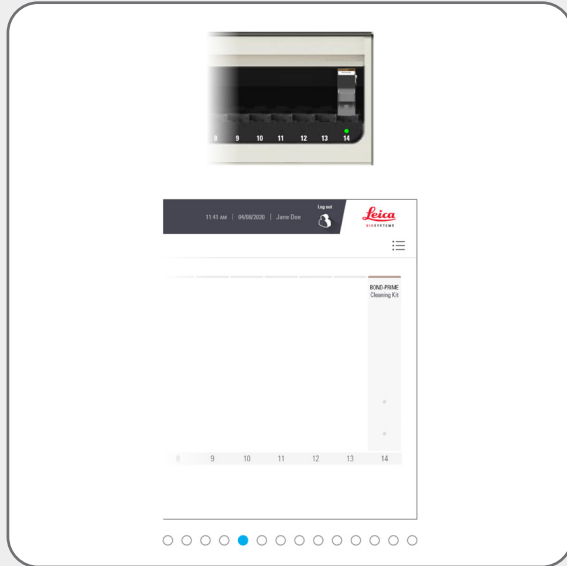
[Lukittujen Reagent Containerien \(reagenssisäiliöt\) täyttäminen \(kirjautuminen vaaditaan\)](#)

[Jäteastioiden tyhjentäminen](#)



Vaaditut puhdistustehtävät

BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) käyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)



Vaaditut puhdistustehtävät

BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) käyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)



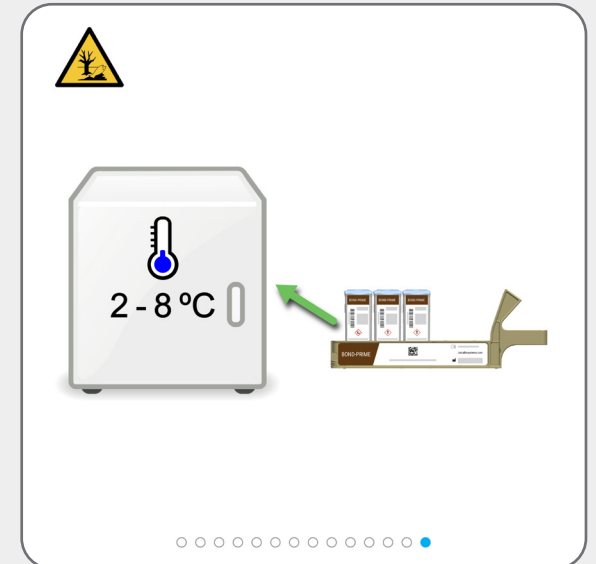
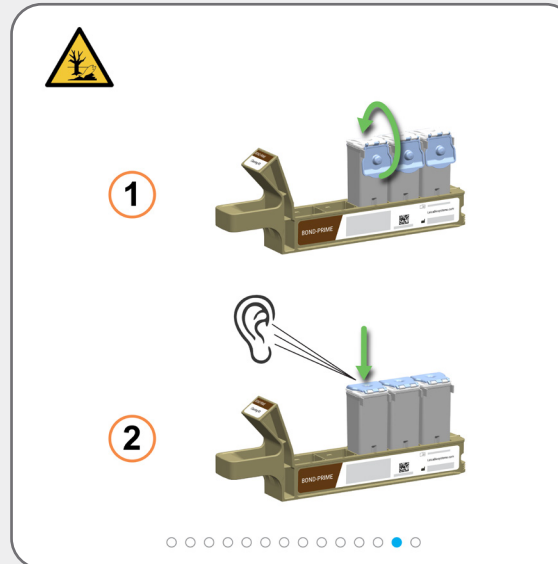
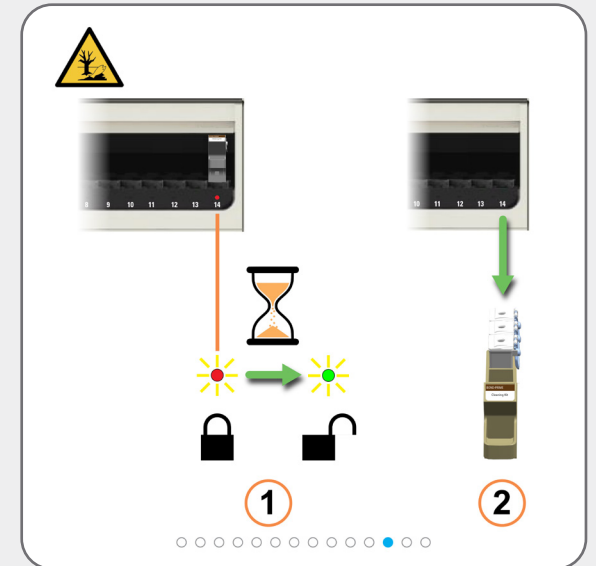
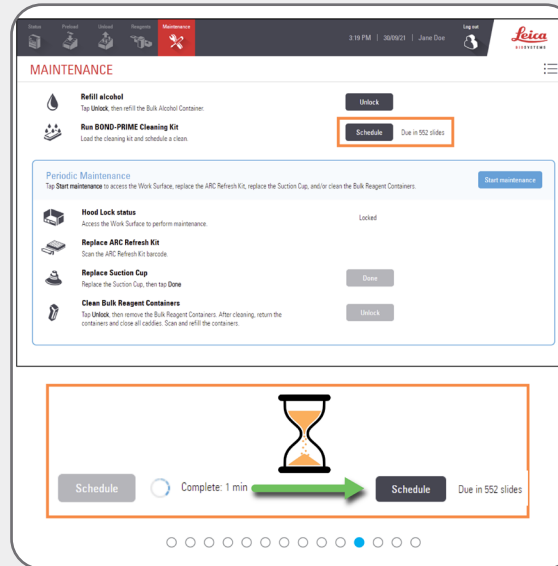
Voit ladata uusia objektilaseja Preload Draweriin (esilatauslaatikko) sen jälkeen, kun **Schedule** (ajastin) -painike ei ole aktiivinen ja pyörivä rengas on näkyvässä.



Puhdistusprosessin päättymisaika näytetään minuutteina.

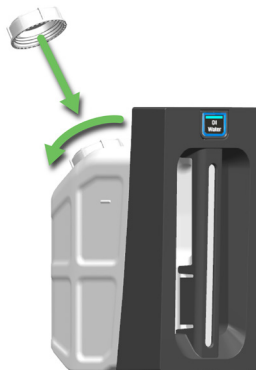
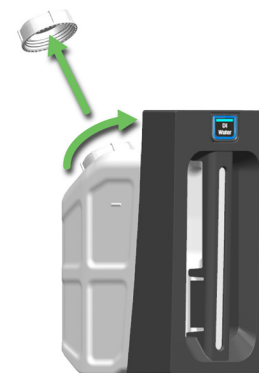
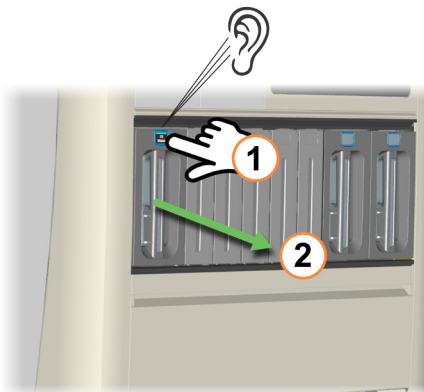


Kun **Schedule** (ajastin) -painike on jälleen aktiivinen, puhdistusprosessi on valmis:



Vaaditut huoltotehtävät

DI Water Containerin (deionisoidun veden säiliö) täyttäminen



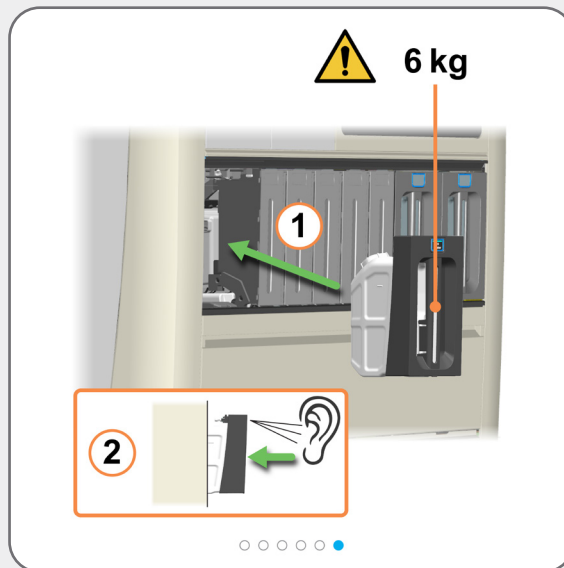
Nosta Bulk DI Water Container (bulkkimääräisen deionisoidun veden säiliö) molemmilla käsillä.

Vaaditut huoltotehtävät

DI Water Containerin (deionisoidun veden säiliö) täyttäminen

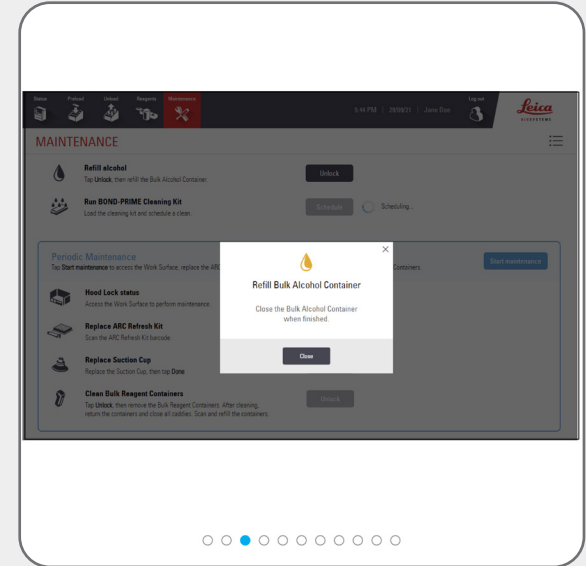
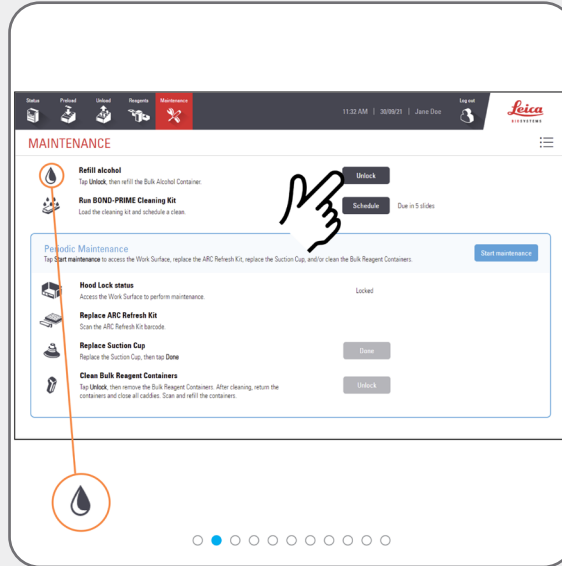


Varmista, että Reagent Containerit (reagenssisäiliöt) on työnnetty kokonaan sisään. Jos näin ei ole, värjäyksen laatu voi heikentyä. Jos värjäyksen suhteen on ongelmia, poista bulkkireagenssisäiliöt ja aseta ne uudelleen.

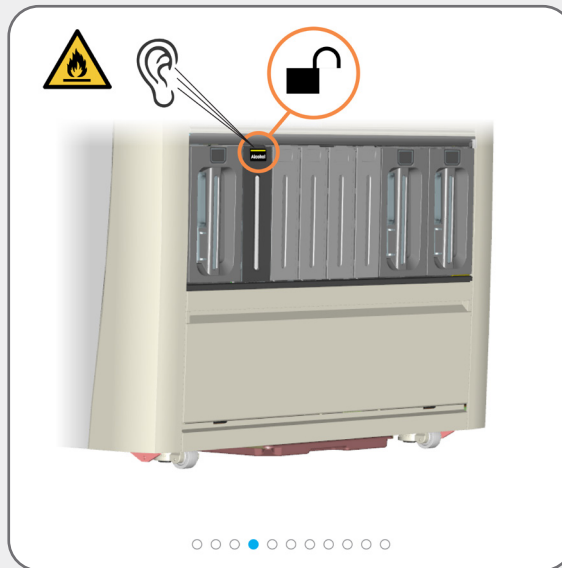


Vaaditut huoltotehtävät

Alcohol Containerin (alkoholisäiliö) täyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)

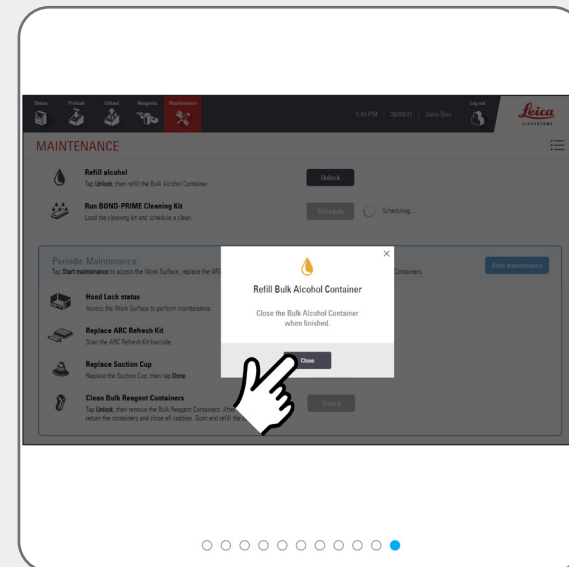
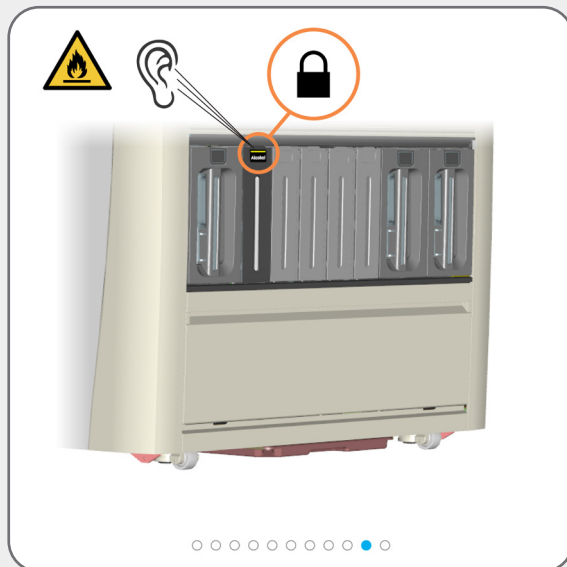
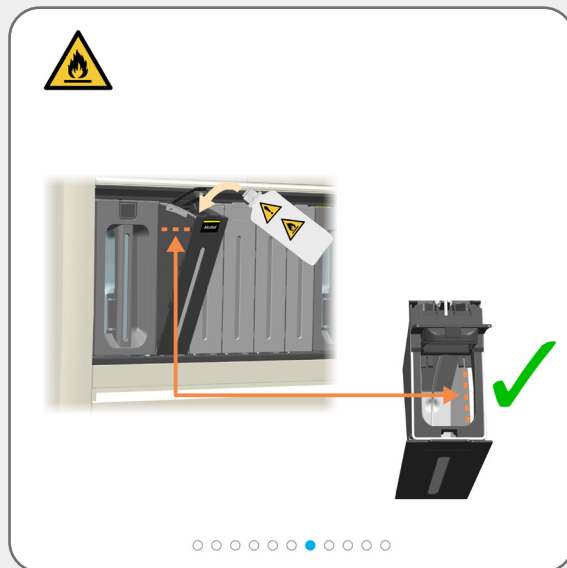


Kuulet napsahduksen, kun säiliön lukitus avautuu. Se pysyy lukitsemattomana vain 30 sekunnin ajan.



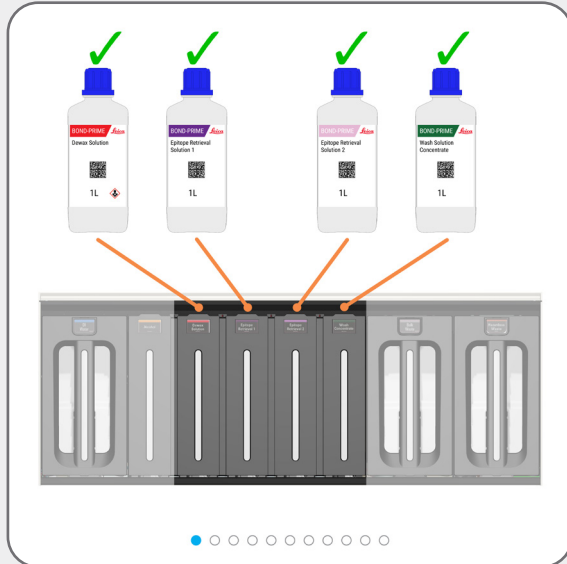
Vaaditut huoltotehtävät

Alcohol Containerin (alkoholisäiliö) täyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)



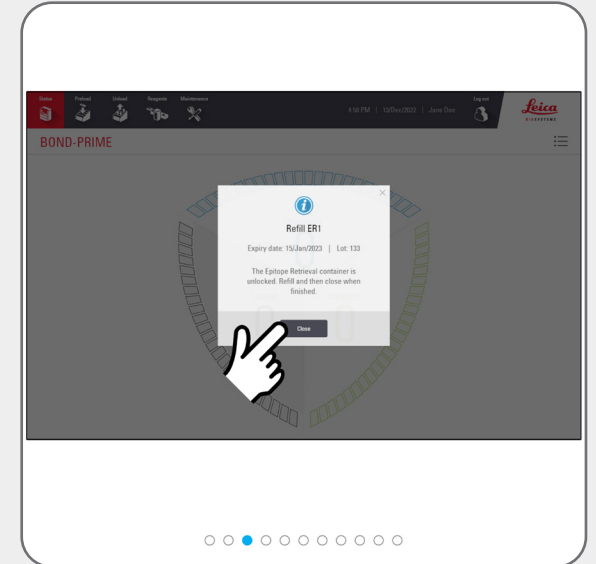
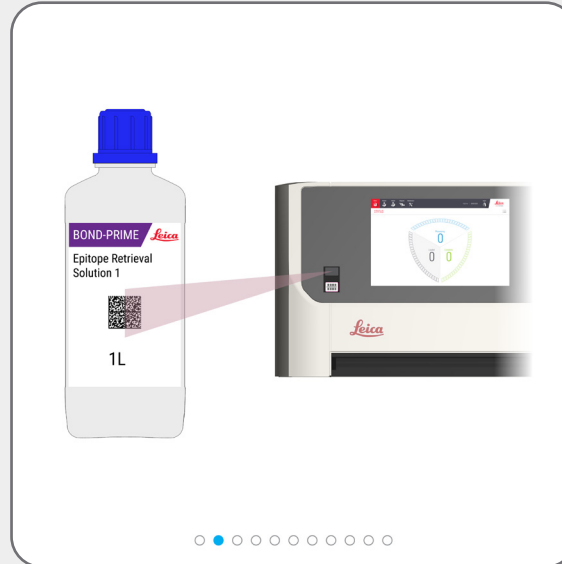
Vaaditut huoltotehtävät

Lukittujen Reagent Containerien (reagenssisäiliöt) täyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)



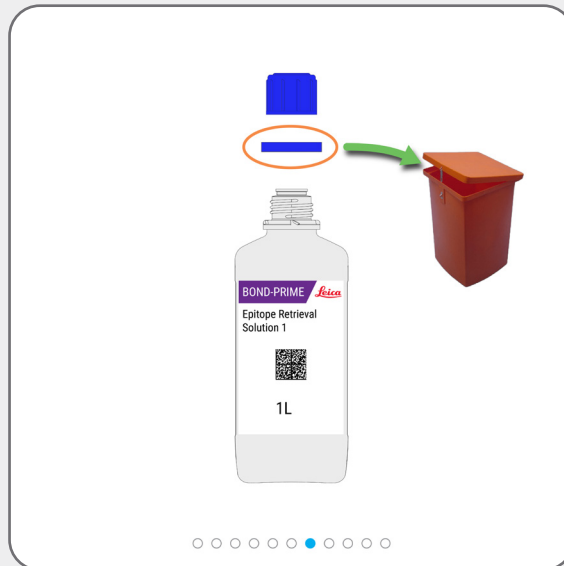
i Kuulet napsahduksen, kun säiliön lukitus avautuu. Se pysyy lukitsemattomana vain 30 sekunnin ajan.

i Aktivoi laser heiluttamalla kättäsi skannerin edessä. Voit myös käyttää pullon heijastusta (kannella) asettaaksesi laserin pullon 2D-viivakoodin päälle.



Vaaditut huoltotehtävät

Lukittujen Reagent Containerien (reagenssisäiliöt) täyttäminen (kirjautuminen vaaditaan)



Vaaditut huoltotehtävät

Jäteastioiden tyhjentäminen



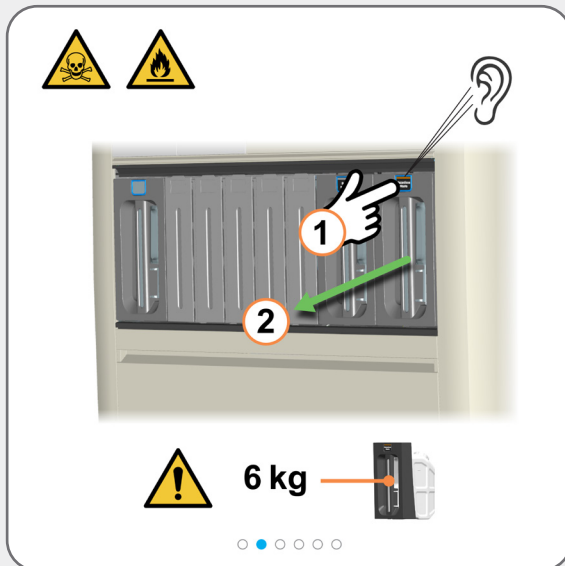
VAROITUS: Sinun on käytettävä vaadittuja henkilösuojaimia ennen prosessointimoduulin huoltamista.



Ohessa esimerkki ongelmajätteestä. Hävitä jäte kaikkien laboratoriotäytä koskevien menettelytapojen ja viranomaismääräysten mukaisesti.

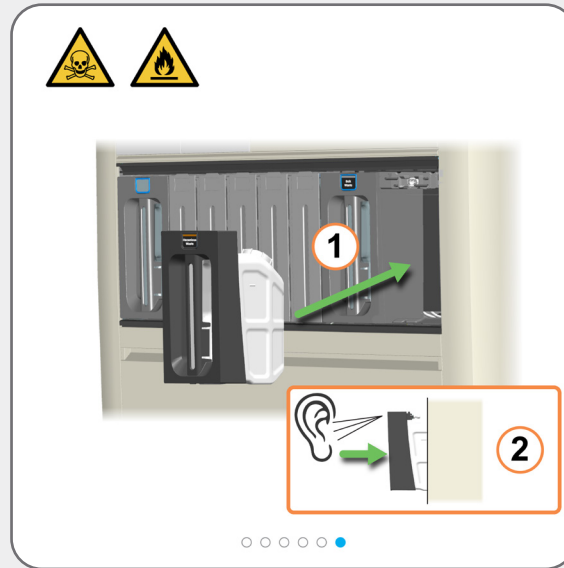


Nosta Bulk Waste Container (bulkijätteen säiliö) ja Hazardous Waste Container (vaarallisen jätteen säiliö) molemmilla käsillä.



Vaaditut huoltotehtävät

Jäteastioiden tyhjentäminen



Tyhjennä ja palauta säiliö nopeasti varmistaaksesi jätekapasiteetin.

Varmista, että jäteastiat on työnnetty kokonaan sisään. Jos näin ei toimita, objektilasit saatetaan hylätä Preload Drawerissa (esilatauslaatikko).

Vaaditut huoltotehtävät

BOND-PRIME ARC Refresh Kitin käyttäminen



[Valitse Huollon käynnistäminen](#)
(kirjautuminen vaaditaan)

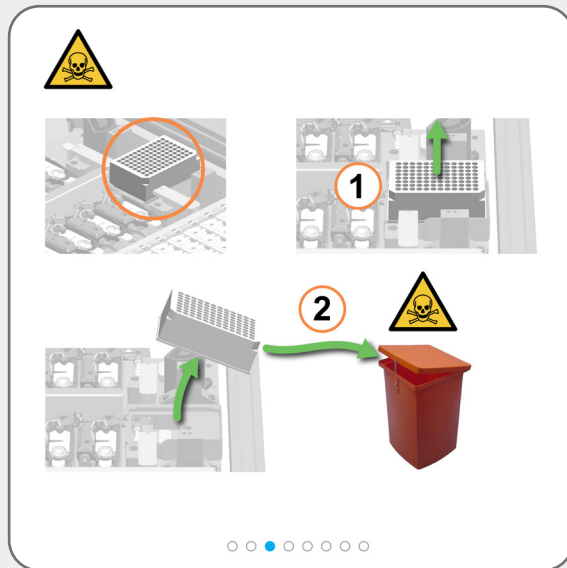
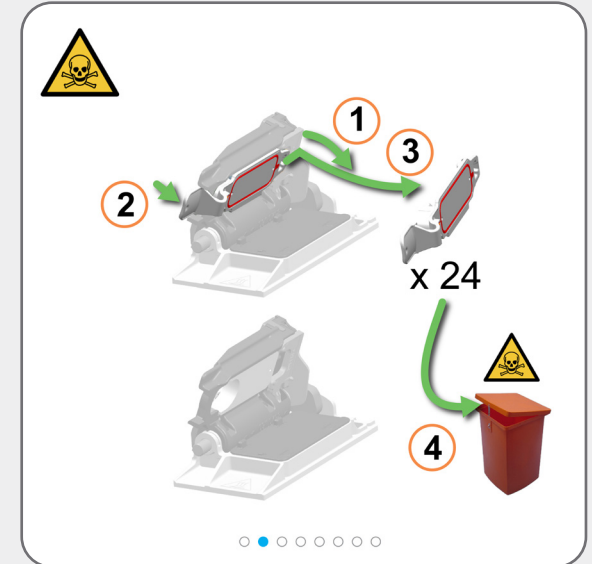
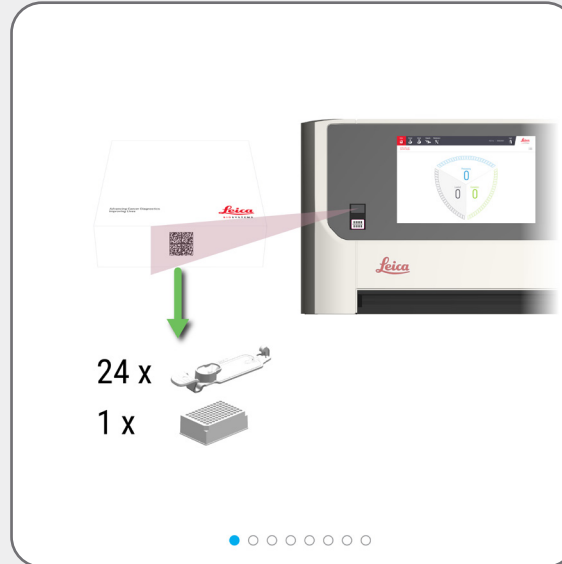
päästäksesi Work Surfaceen
(työskentelytaso) ja avataksesi ARC
Modulet (ARC-moduulit).



VAROITUS: Sinun on käytettävä
vaadittuja henkilösuojaimia ennen
prosessointimoduulin huoltamista.



Suorita tämä tehtävä 7 500
objektilasain tai 8 kuukauden välein,
kumpi tahansa täyttyä ensin.



Ole varovainen poistaessasi ja
hävittäessäsi Mixing Well Platea
(sekoitusaltaan levy), jotta nestettä
ei läikkyisi.

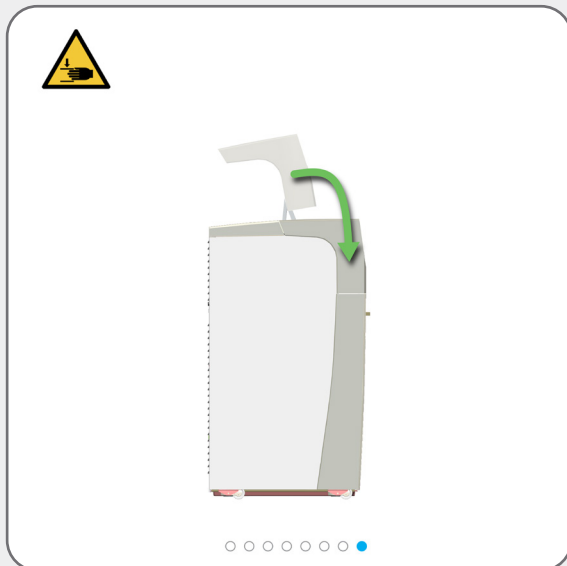
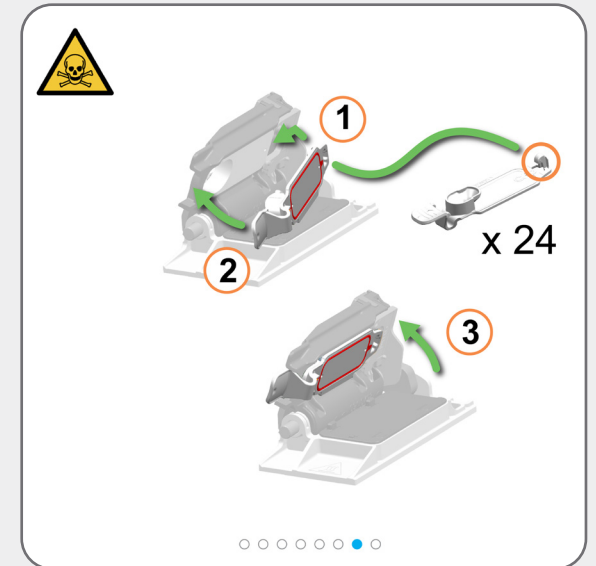
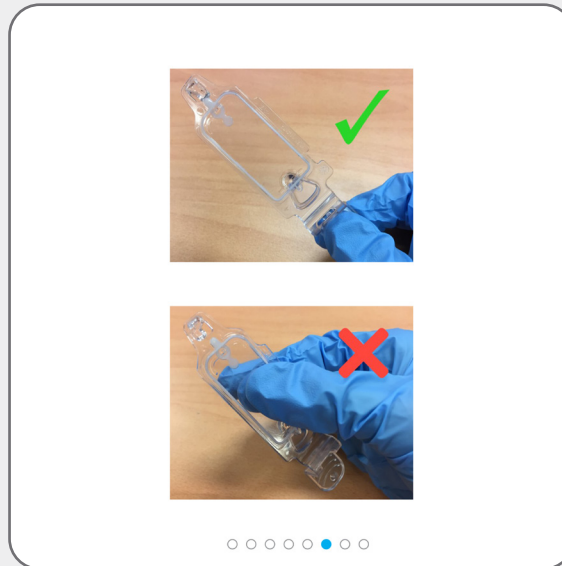
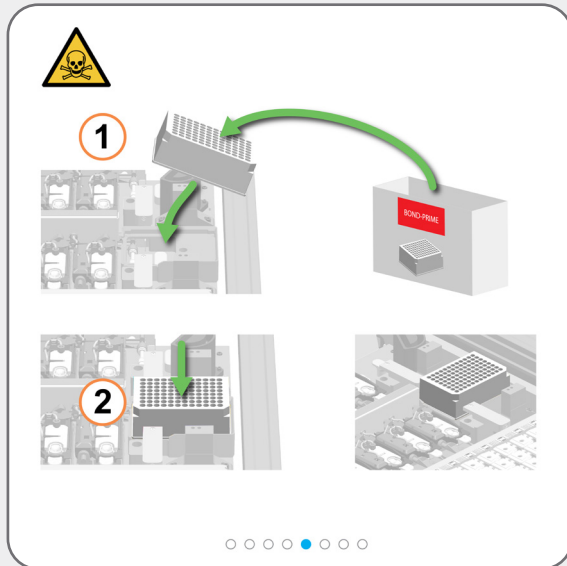


Mixing Well Platen (sekoitusaltaan
levy) suuntaus alla olevassa Mixing
Blockissa (sekoitusblokki) ei ole
tärkeää, mutta se on asetettava
pidikkeeseen oikein.



Vaaditut huoltotehtävät

BOND-PRIME ARC Refresh Kitin käyttäminen



Prosessointimoduuli sulkee ARC Moduulet (ARC-moduulit) automaattisesti, kun lopetat huollon.



Jos et enää tarvitse pääsyä Work Surfaceen (työskentelytaso), sulje kansi ja valitse [Huollon lopettaminen \(kirjautuminen vaaditaan\)](#).

Vaaditut huoltotehtävät

Huollon lopettaminen (kirjautuminen vaaditaan)



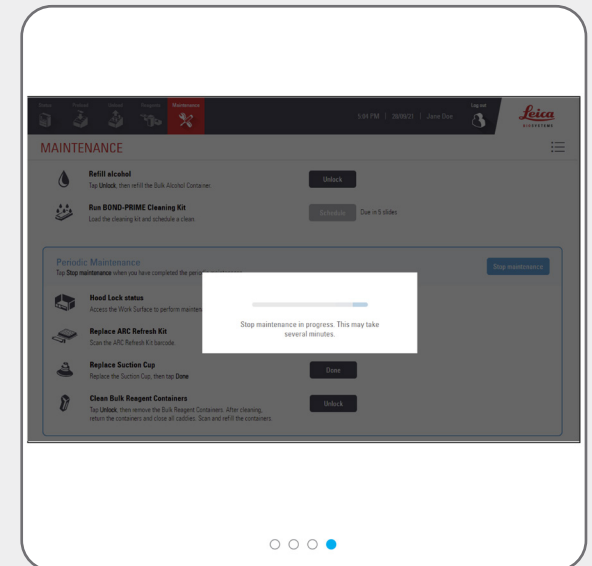
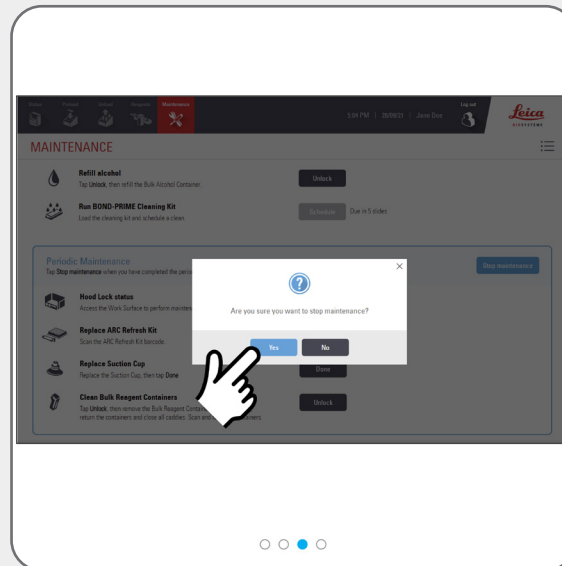
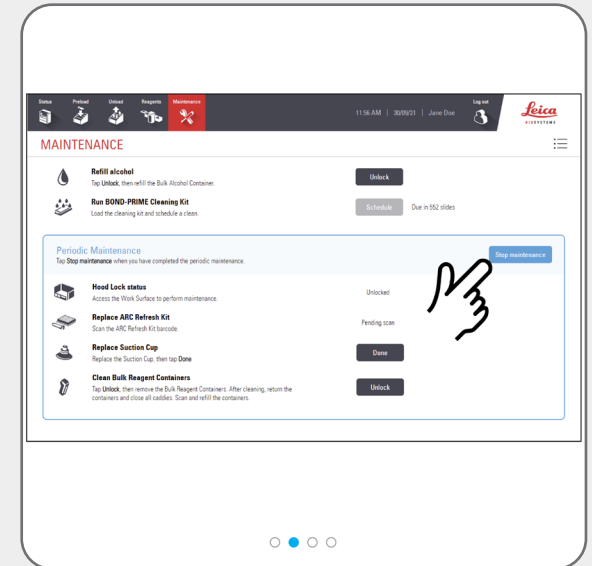
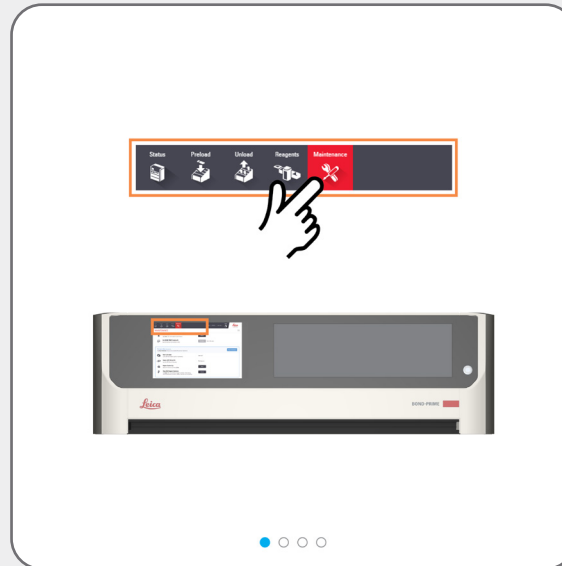
Katso ennen huollon lopettamista tilanäyttöä.



Varmista ennen huollon lopettamista, että Mixing Well Plate (sekoitusaltaan levy) ja Covertile-suojukset ovat paikoillaan, Reagent Containerien (reagenssisäiliöt) tilavuus on riittävä ja kansi on suljettu.



Odota hetki prosessointimoduulin valmistautuessa palaamaan kliiniseen toimenpiteeseen.



Sammutustoimenpiteet

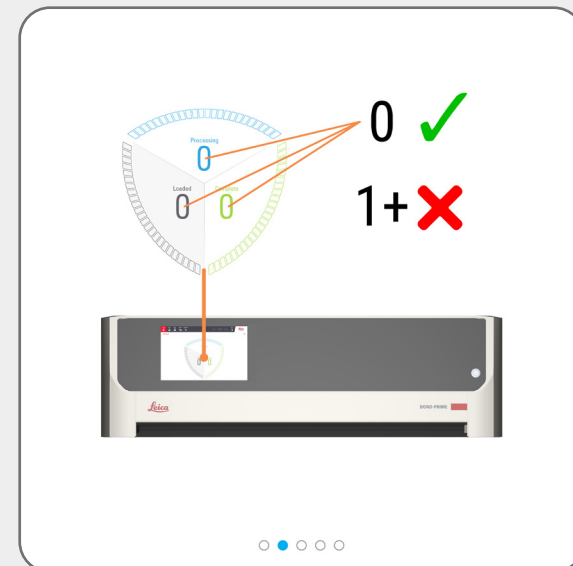
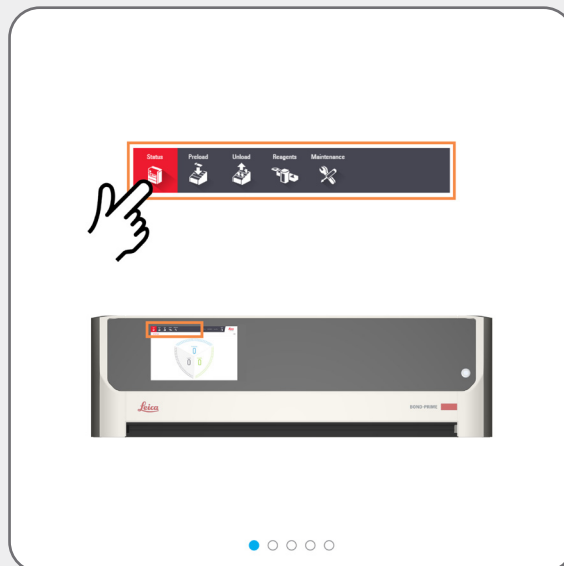
Prosessointimoduulin sammuttaminen (kirjautuminen vaaditaan)



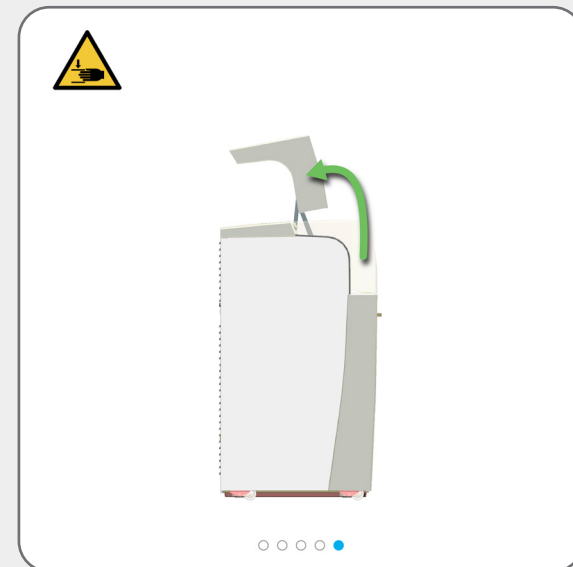
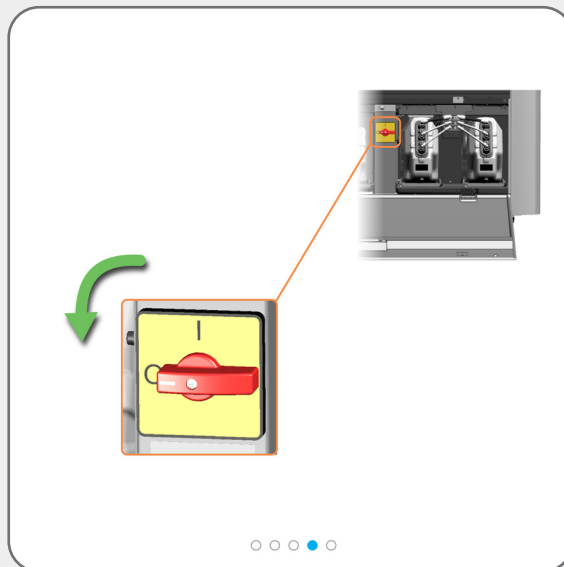
Sammuta prosessointimoduuli, kun sammutat ja käynnistät virran uudelleen (uudelleenkäynnistys).

Katso tilanäyttöä ennen prosessointimoduulin sammuttamista.

Varmista, että objektilaseja ei juuri nyt käsitellä eikä Preload and Unload Drawereissa (esilatauslaatikot ja purkulaatikko) ole objektilaseja.



Jos prosessointimoduulin sammuttaminen on turvallista, näet asiasta ilmoituksen näytöllä.



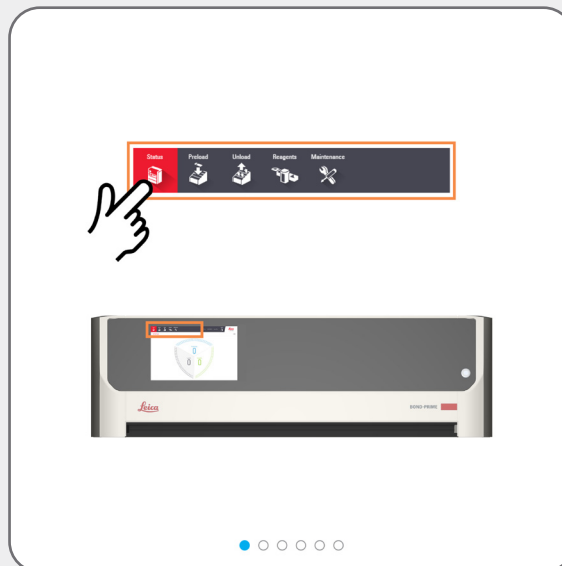
Sammutustoimenpiteet

Prosessointimoduulin irrotus (kirjautuminen vaaditaan)



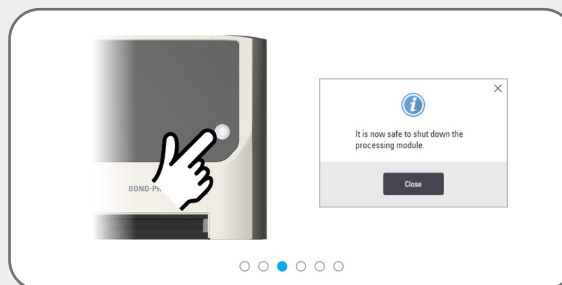
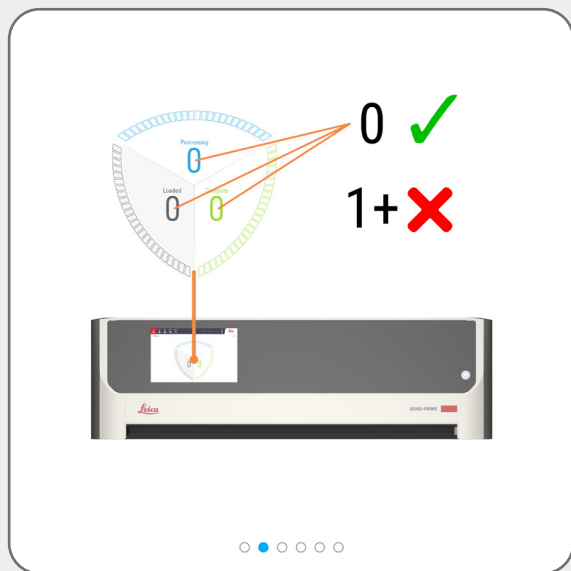
Prosessointimoduuli on sammutettava ja irrotettava:

- » ennen prosessointimoduulin siirtämistä uuteen paikkaan
- » ennen prosessointimoduulin poistamista käytöstä

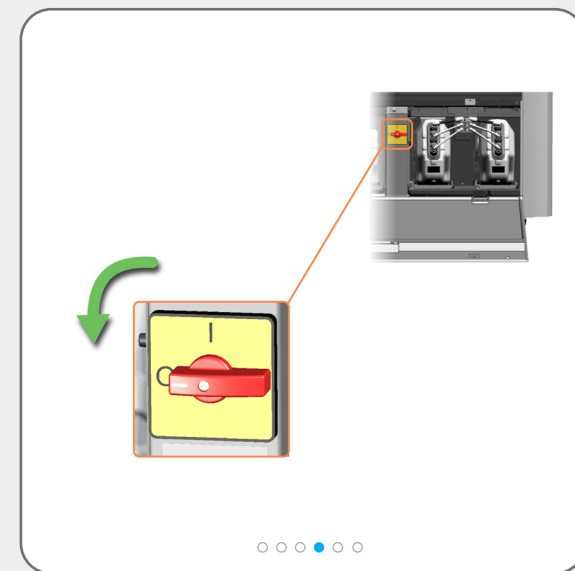


Katso tilanäyttöä ennen prosessointimoduulin sammuttamista ja irrotusta.

Varmista, että objektilaseja ei juuri nyt käsitellä eikä Preload and Unload Drawereissa (esilatauslaatikot ja purkulaatikko) ole objektilaseja.



Jos prosessointimoduulin sammuttaminen on turvallista, näet asiasta ilmoituksen näytöllä.



Sammutustoimenpiteet

Prosessointimoduulin irrotus (kirjautuminen vaaditaan)



Prosessointimoduulia on ehkä siirrettävä, jotta pääsisit paremmin käsiksi takapaneelin liittimiin.

